

表面・界面のレオロジー特集号への投稿募集

Society5.0の実現を目指し、材料・デバイスの複合化や集積化、また、高精度な微細加工やインクジェット技術が展開されています。特に、ソフトマテリアル分野においては、薄膜や微小液滴などナノスケールの材料が扱われ、そこでは表面・界面の理解と制御が一層重要になってきます。一般に、表面・界面はバルクとは異なる物性を示し、更にナノスケールの材料では特異な現象が観られることが多くあります。したがって、表面・界面のレオロジーを正しく理解し、制御することは、学術的な興味だけでなく、今後の製造技術の発展にとっても極めて重要です。日本レオロジー学会誌では、表面・界面分野のレオロジー研究成果を広く知らしめる場を提供し、この分野の更なる発展を後押しするために、表面・界面のレオロジー特集号を企画しました。本特集号では、産業界や研究機関における様々な表面・界面のレオロジストからの研究論文を募集します。何卒、多くの皆様からご投稿頂きますようお願い申し上げます。

発刊予定月：2024年4月15日(月)

予定巻号：日本レオロジー学会誌 52巻 2号

原稿提出方法：Web投稿サイトよりご投稿ください

<https://mc.manuscriptcentral.com/jsrj>

※本文に「表面・界面レオロジー特集号」と明記してください

投稿規定：日本レオロジー学会ホームページをご覧ください

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/rheology/_pubinfo/-char/ja

原稿締切：2023年11月30日(木)

問合せ先：山本 智 九州大学

E-mail: s-yamamoto@cstf.kyushu-u.ac.jp

以上